

证券代码：603228

证券简称：景旺电子

## 深圳市景旺电子股份有限公司 投资者关系活动记录表

(记录表编号：2024-0601)

投资者关系 活动类别	<input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 一对一沟通	<input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 其他：
时间	2024年6月1日-6月28日		
地点/方式	线下调研交流、券商策略会		
参与单位 (或人员)	上海证券交易所2024“我是股东”调研团； 财通证券、长江证券、华创证券、山西证券、天风证券、中泰证券、中银证券、招商证券等； 安信基金、博时基金、长城基金、长信基金、大成基金、德邦基金、富国基金、广发基金、国泰基金、国投瑞银基金、海富通基金、华安基金、华宝基金、华金证券、华夏基金、建信基金、交银施罗德基金、南方基金、浦银安盛基金、泰信基金、西部利得基金、兴全基金、易方达基金、永赢基金、招商基金、中欧基金、中信保诚基金、中银基金等； 长江养老、平安养老、平安资产、人保资产等。		
上市公司 接待人员	董事会秘书：黄恬先生 证券事务代表：蒋靖怡女士		
活动 主要内容	调研会议互动问答的主要内容如下：  问：公司近期稼动率情况？订单是否充足？ 答：公司稼动率保持在合理水平，今年以来，下游需求改善明显，公司订单储备充足，部分产线排期较为紧张，公司秉承“以销定产、柔性生产”的策略，全力满足每一位客户的需求。		

**问：公司今年上半年业绩情况如何？**

**答：**2024 年一季度，公司实现营业收入 27.43 亿元，同比增长 17.16%，实现归母净利润 3.18 亿元，同比增长 50.30%；二季度，公司订单充足，产品创新和市场开拓等各项工作持续推进，具体财务数据敬请关注公司定期报告。

**问：珠海金湾基地的建设情况和产品的下游应用领域？**

**答：**珠海金湾生产基地首期于 2021 年 7 月正式投产，包含 HLC 工厂和 HDI（含 SLP）工厂，是公司高技术、高附加值产品的灯塔工厂，产品多应用于服务器、高端消费类电子、AR/VR、通信、汽车等领域。2023 年金湾基地在新客户导入和高端产品开发方面取得突破性进展，2024 年各项业务持续推进，产量产值稳步提升。

**问：公司是否有布局可用于车路云的产品？**

**答：**“车路云一体化”是在汽车业与人工智能、大模型等技术的深度融合基础上发展而来，包括大量路侧、车侧、网端、云端的智能基础设施建设。PCB 是电子设备中不可或缺的组成部分，被广泛应用于“车路云一体化”中。路侧和车侧，公司产品可被用于毫米波雷达、摄像头、激光雷达、ADCU、高级驾驶辅助系统等设施中；云端，公司高多层、HDI、SLP 等产品可用于存储芯片/模组及数据中心。未来，公司将围绕智能网联车辆及无人驾驶运营场景的实际需求进行相关产品的进一步开发和部署，积极争取相关项目机会。

**问：公司光模块业务进展如何？**

**答：**2023 年以来，公司光模块业务进展较快，已批量生产 10G/25G/100G/200G/400G/800G 光模块产品，今年上半年已完成 1.6T 光模块产品的打样并具备量产能力。

**问：请问当前 AI 领域的发展对公司 PCB 业务是否产生积极影响？**

**答：**AI 应用的不断升级和硬件的加速迭代，对于云端的高算力和高速传输的需求日益增长，AI 终端持续渗透，PCB 和 FPC 的规格持续提升，预计产品将朝着高频高速、高密度、小型化、轻薄化、热管理等方向发展，FPC、HDI（含 SLP）、软硬结合板、ABF 载板等高端产品的需求将提升。公司在 AIPC、AI PHONE、AI 服务器等领域均有相应的技术储备和客户需求，相关产品的逐步放量有望对公司业绩带来成长。

**问：公司如何看待 PCB 行业发展前景？**

**答：**PCB 行业属于电子信息产业的基石，目前中国大陆仍占据 PCB 制造的主导地位，贡献超过一半的全球 PCB 产值。从产品结构来看，全球 PCB 产业均努力朝着高密度、高可靠性、低损耗和绿色生产的方向发展，为了摆脱中低端 PCB 产品竞争加剧的困境，未来产品结构升级、柔性生产和差异化创新将成为 PCB 企业长期的战略发展方向。

随着通用人工智能应用爆发式增长和算力革命的飞速发展，对于人工智能训练和推理的需求持续增加，硬件终端也朝着集成化、智能化、小型化、轻量化、低能耗等方向不断迭代，进而促使 PCB 持续向高密度、高集成、高速高频、高散热、轻薄化和小型化等方向发展；同时伴随汽车电动化、智能化、网联化渗透率提升，需要 PCB 在传统的汽车应用场景之外实现高速信号传输、耐高压高温、人车互动和车路/车车互联等新兴需求，从而带动了高阶 HDI、高频高速板、散热板、陶瓷基板等市场规模的增长。据 prisma 统计，未来五年电子行业中服务器/存储市场将成为最强劲的增长势力，汽车电子将成为第二大增长动力。

**问：大宗商品价格上涨对公司影响有多大？**

**答：**公司主要原材料包括铜球、铜箔、覆铜板、半固化片、金盐等。近期受铜价等大宗商品价格变化影响，部分原材料价格有所上升，公司秉承与上下游共建可持续发展生态圈的理念，积极与供应商和客户保持沟通，将材料成本对公司的经营影响控制在合理范围内。

	<p><b>问：公司是否有再融资的计划？</b></p> <p><b>答：</b>目前公司经营性现金流情况良好，资产负债率在合理水平，银行授信额度充足，短期没有再融资计划。公司将根据战略规划、市场环境及实际需求变化制定公司中长期投融资计划。</p> <p><b>问：请介绍公司的人才培养工作情况？</b></p> <p><b>答：</b>2024年，在2023年培训体系搭建基础上，公司重点推动人才梯队建设，持续优化专业人才培养，不断提升人才队伍的整体素质和竞争力，为公司的可持续发展夯实人才基础。</p> <p><b>注：</b>调研过程中，公司严格遵照《信息披露管理制度》等规定，未出现未公开重大信息泄露等情况。</p>
附件	无
记录时间	2024年6月30日整理